



平成26年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年10月29日

上場取引所 東

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

コード番号 8035 URL <http://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長

(氏名) 東 哲郎

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員

(氏名) 原田 芳輝

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 平成25年11月8日

配当支払開始予定日

平成25年12月2日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第2四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第2四半期	254,500	△4.5	△1,822	—	588	△96.2	2,476	△59.3
25年3月期第2四半期	266,600	△18.3	12,202	△66.9	15,459	△61.1	6,090	△77.2

(注) 包括利益 26年3月期第2四半期 8,789百万円 (362.9%) 25年3月期第2四半期 1,898百万円 (△90.5%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第2四半期	13.82	13.79
25年3月期第2四半期	33.99	33.94

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
26年3月期第2四半期	798,814	607,490	74.5
25年3月期	775,527	605,127	76.5

(参考) 自己資本 26年3月期第2四半期 595,213百万円 25年3月期 593,032百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	25.00	—	26.00	51.00
26年3月期	—	25.00	—	—	—
26年3月期(予想)	—	—	—	25.00	50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成25年3月期の第2四半期末配当金の内訳は、普通配当15円、記念配当10円です。

平成25年3月期の期末配当金の内訳は、普通配当16円、記念配当10円です。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	605,000	21.7	30,000	139.1	33,000	97.6	23,000	278.5	128.36

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、【添付資料】6ページ「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期2Q	180,610,911 株	25年3月期	180,610,911 株
26年3月期2Q	1,422,727 株	25年3月期	1,424,203 株
26年3月期2Q	179,187,591 株	25年3月期2Q	179,172,561 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】5ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、平成25年10月29日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、開催と同時に当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	5
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	6
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	6
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	6
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	6
3. 四半期連結財務諸表	7
(1) 四半期連結貸借対照表	7
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	8
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	10
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	11
(継続企業の前提に関する注記)	11
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	11
(セグメント情報等)	11

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におきましては、米国及び日本において景気回復傾向にあり、中国では減速傾向となったものの成長が持続しております。欧州においてもドイツや英国などで景気の持ち直しの動きが見られるなど、総じて世界経済は回復の傾向を見せております。

当社グループの参画しておりますエレクトロニクス産業においては、新興国向けを中心にスマートフォンの需要は引き続き拡大しており、タブレットPCを含めたモバイル端末は堅調に推移しています。また、モバイル端末の世界的な拡がり等によって、クラウドサービスが成長しており、データセンター向けのメモリー需要も伸びてきております。

このような状況のもと、当社グループの受注は前第4四半期以降、回復基調にあり、当第2四半期連結累計期間の売上高は2,545億円(前年同期比4.5%減)、営業損失18億2千2百万円(前年同期は122億2百万円の営業利益)、経常利益5億8千8百万円(前年同期比96.2%減)、また、四半期純利益は24億7千6百万円(前年同期比59.3%減)となりました。

当社とApplied Materials, Inc.は、半導体及びディスプレイ製造装置業界における「グローバル・イノベーター」となることを目指し、平成25年9月24日に株式対価による経営統合の契約を締結いたしました。この経営統合は、当社とApplied Materials, Inc.の相互に補完し合う技術と製品の強みを活かすことにより、戦略的に重要な先端技術を提供することを目的としております。なお、本経営統合にあたっては両社の株主総会の承認及び各国において適用される競争法に基づく関係当局による承認等を前提としており、平成26年後半の完了を見込んでおります。詳細につきましては、平成25年9月24日発表の「東京エレクトロン株式会社とApplied Materials, Inc.の経営統合に関する合意について」をご確認ください。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

なお、第1四半期連結会計期間から、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に基づき報告セグメントを変更しており、以下の前年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

① 半導体製造装置

DRAM及びNANDフラッシュメモリーの需給バランスは引き締まって推移し、永らく投資を控えてきたメモリーメーカーにおける増産投資再開の動きも出始めるなど、受注は改善傾向にあります。また、ロジック半導体に関しましても、モバイル端末向けを中心に半導体メーカーの設備投資は堅調に推移しております。このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は1,947億7千3百万円(前年同期比9.3%減)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

液晶パネルメーカーの設備投資は、中国を中心に比較的堅調に推移しており、FPD製造装置市場は前年度の大幅な調整局面から回復の傾向を見せております。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、93億9千3百万円(前年同期比2.5%増)となりました。

③ PV(太陽光パネル)製造装置

サンベルト地域等における新規顧客開拓に努めておりますが、当第2四半期連結累計期間における新規受注には至りませんでした。このような状況のもと、当社は薄膜シリコン太陽光パネルの変換効率の向上に努めてまいります。当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、32億8千8百万円(前年同期は6千4百万円の売上高)となりました。

④ 電子部品・情報通信機器

電子部品事業においては、自動車、産業機器関連の部品需要が回復基調となっており、情報通信機器関連事業においては、コンピュータシステム関連機器販売が前年並みに推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、467億8千6百万円(前年同期比10.2%増)となりました。

⑤ その他

当セグメントの当第2四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、2億5千8百万円(前年同期比8.2%増)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
売上高	266,600	230,699	254,500	151,048
半導体製造装置	214,666	177,359	194,773	119,828
日本	20,218	20,059	33,233	21,585
米国	55,782	61,310	44,817	29,715
欧州	23,402	15,299	13,575	7,909
韓国	38,677	18,833	28,864	17,679
台湾	58,795	46,591	56,059	31,550
中国	11,863	8,088	9,635	4,924
東南アジア他	5,927	7,177	8,587	6,463
F P D製造装置	9,166	10,911	9,393	4,486
P V製造装置	64	19	3,288	1,225
電子部品・情報通信機器	42,465	42,199	46,786	25,359
その他	238	209	258	146
営業利益(△損失)	12,202	346	△1,822	7,824
経常利益(△損失)	15,459	1,237	588	10,487
四半期純利益(△損失)	6,090	△14	2,476	5,452

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

【生産及び受注の実績】

1. 生産実績

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
半導体製造装置	184,976	158,899	185,142	105,784
F P D製造装置	6,565	10,432	10,815	4,777
P V製造装置	67	3	3,358	1,212
合計	191,609	169,335	199,316	111,774

(注) 1. 金額は販売価格によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 受注実績(受注高)

(単位：百万円)

	前期上半期	前期下半期	当期上半期	
			当期第1Q	当期第2Q
半導体製造装置	142,957	199,589	251,898	154,189
F P D製造装置	10,850	11,031	20,843	6,351
P V製造装置	64	19	2,286	1,101
電子部品・情報通信機器	43,290	42,376	48,607	24,735
その他	238	209	258	146
合計	197,401	253,225	323,893	186,524

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 受注実績(受注残高)

(単位：百万円)

	前期第2Q末	前期期末	当期第1Q末	当期第2Q末
半導体製造装置	118,702	141,616	164,587	198,948
F P D製造装置	15,885	16,005	25,584	27,449
P V製造装置	—	8,421	7,618	7,494
電子部品・情報通信機器	14,608	14,785	17,231	16,606
その他	—	—	—	—
合 計	149,196	180,829	215,022	250,499

(注) 1. セグメント間取引については、相殺消去しております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第2四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ224億5百万円増加し、5,439億6百万円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の増加172億1千4百万円、たな卸資産の増加203億1千1百万円、有価証券に含まれる短期投資の減少164億8千8百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から38億8千1百万円減少し、1,318億1千6百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から13億9千4百万円増加し、613億1千2百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から33億6千8百万円増加し、617億7千9百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から232億8千6百万円増加し、7,988億1千4百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ168億2千9百万円増加し、1,234億9千9百万円となりました。主として、支払手形及び買掛金の増加100億3千3百万円、前受金の増加90億8千6百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ40億9千4百万円増加し、678億2千4百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ23億6千3百万円増加し、6,074億9千万円となりました。主として、四半期純利益24億7千6百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当46億5千8百万円の実施による減少、連結子会社の決算期変更等による利益剰余金の減少32億4千4百万円、円安の影響等による為替換算調整勘定の増加71億9千9百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は74.5%となりました。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ46億6千8百万円増加し、899億8千2百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,408億7千6百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ92億7千1百万円減少し、2,308億5千8百万円となりました。当第2四半期連結結果計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ741億3千7百万円減少の2億1千7百万円の支出となりました。主な要因につきましては、減価償却費127億4千9百万円、仕入債務の増加90億5千8百万円、前受金の増加82億1百万円、未収消費税等の減少75億2千9百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加203億1千4百万円、売上債権の増加163億5千2百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の減少による収入139億3千5百万円、有形固定資産の取得による支出52億4千6百万円により、前年同期の842億1千8百万円の支出に対し71億4千8百万円の収入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に短期借入の増加による収入41億1百万円、長期借入の増加による収入20億円、配当金の支払46億5千8百万円により、前年同期の64億7千3百万円の支出に対し11億2百万円の収入となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年3月期の連結業績につきましては、半導体製造装置事業の好調な受注を受け、主に同事業の下期売上高が増加する見込みであるため、平成25年10月23日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」において、通期の連結業績予想を以下のとおり上方修正いたしました。

平成26年3月期の連結業績予想

	通期予想
売上高	6,050億円 (前年同期比 21.7%増)
半導体製造装置	4,750億円 (前年同期比 21.2%増)
F P D製造装置	260億円 (前年同期比 29.5%増)
P V製造装置	70億円
電子部品・情報通信機器	965億円 (前年同期比 14.0%増)
その他	5億円 (前年同期比 11.6%増)
営業利益	300億円 (前年同期比139.1%増)
経常利益	330億円 (前年同期比 97.6%増)
当期純利益	230億円 (前年同期比278.5%増)

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(連結子会社の事業年度等に関する事項の変更)

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった一部の在外子会社については、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っていましたが、連結財務情報のより適正な開示を図るため、第1四半期連結会計期間より、決算日を3月31日に変更又は連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用する方法に変更しております。

なお、平成25年1月1日から平成25年3月31日までの損益については、利益剰余金の増減として調整しており、キャッシュ・フローについては、連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額として表示しております。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (平成25年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	49,632	56,849
受取手形及び売掛金	100,500	117,715
有価証券	190,497	174,009
商品及び製品	87,397	100,659
仕掛品	33,402	40,513
原材料及び貯蔵品	14,898	14,836
その他	46,351	39,813
貸倒引当金	△1,179	△490
流動資産合計	521,501	543,906
固定資産		
有形固定資産	135,697	131,816
無形固定資産		
のれん	38,372	38,972
その他	21,545	22,340
無形固定資産合計	59,918	61,312
投資その他の資産		
その他	60,522	63,707
貸倒引当金	△2,112	△1,927
投資その他の資産合計	58,410	61,779
固定資産合計	254,026	254,908
資産合計	775,527	798,814
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	36,261	46,294
製品保証引当金	8,344	8,732
その他の引当金	6,908	6,817
その他	55,155	61,656
流動負債合計	106,670	123,499
固定負債		
退職給付引当金	56,643	58,155
その他の引当金	580	576
その他	6,505	9,093
固定負債合計	63,730	67,824
負債合計	170,400	191,324
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,023	78,023
利益剰余金	467,920	462,490
自己株式	△9,588	△9,576
株主資本合計	591,315	585,898
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	4,214	4,578
繰延ヘッジ損益	△14	20
為替換算調整勘定	△2,483	4,715
その他の包括利益累計額合計	1,716	9,314
新株予約権	1,374	1,559
少数株主持分	10,720	10,718
純資産合計	605,127	607,490
負債純資産合計	775,527	798,814

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
売上高	266,600	254,500
売上原価	180,963	174,453
売上総利益	85,637	80,046
販売費及び一般管理費		
研究開発費	37,417	38,440
その他	36,017	43,428
販売費及び一般管理費合計	73,434	81,869
営業利益又は営業損失(△)	12,202	△1,822
営業外収益		
受取配当金	204	1,747
補助金収入	790	907
その他	2,390	1,327
営業外収益合計	3,385	3,981
営業外費用		
為替差損	—	1,338
その他	127	232
営業外費用合計	127	1,570
経常利益	15,459	588
特別利益		
固定資産売却益	283	79
その他	—	18
特別利益合計	283	98
特別損失		
減損損失	4	873
組織再編費用	132	—
その他	66	135
特別損失合計	203	1,009
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	15,539	△321
法人税等	7,057	△2,903
過年度法人税等	2,194	—
少数株主損益調整前四半期純利益	6,287	2,582
少数株主利益	196	105
四半期純利益	6,090	2,476

四半期連結包括利益計算書
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	6,287	2,582
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,993	368
繰延ヘッジ損益	78	65
為替換算調整勘定	△2,474	5,773
その他の包括利益合計	△4,388	6,206
四半期包括利益	1,898	8,789
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,681	8,619
少数株主に係る四半期包括利益	217	169

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	15,539	△321
減価償却費	11,789	12,749
のれん償却額	689	2,139
退職給付引当金の増減額(△は減少)	919	1,474
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△575	△1,014
賞与引当金の増減額(△は減少)	△1,996	△328
製品保証引当金の増減額(△は減少)	△832	99
受取利息及び受取配当金	△847	△2,424
売上債権の増減額(△は増加)	54,615	△16,352
たな卸資産の増減額(△は増加)	14,836	△20,314
仕入債務の増減額(△は減少)	△14,319	9,058
未収消費税等の増減額(△は増加)	10,118	7,529
未払消費税等の増減額(△は減少)	△25	△1,263
前受金の増減額(△は減少)	△12,318	8,201
その他	△2,434	△2,043
小計	75,156	△2,811
利息及び配当金の受取額	651	2,262
利息の支払額	△20	△39
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△1,867	371
営業活動によるキャッシュ・フロー	73,920	△217
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の増減額(△は増加)	△5,227	△48
短期投資の増減額(△は増加)	△50,499	13,984
有形固定資産の取得による支出	△11,811	△5,246
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出	△15,830	—
事業譲受による支出	△1,097	—
その他	248	△1,540
投資活動によるキャッシュ・フロー	△84,218	7,148
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△1,308	4,101
長期借入れによる収入	—	2,000
配当金の支払額	△4,837	△4,658
その他	△328	△339
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,473	1,102
現金及び現金同等物に係る換算差額	△352	△2,158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△17,125	5,875
現金及び現金同等物の期首残高	158,776	85,313
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	—	△1,206
現金及び現金同等物の四半期末残高	141,651	89,982

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」、「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」、「PV(太陽光パネル)製造装置」及び「電子部品・情報通信機器」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、プラズマエッチング装置、熱処理成膜装置、枚葉成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、プラズマエッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「PV製造装置」は、薄膜シリコン太陽光パネル用製造装置の開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「電子部品・情報通信機器」は、集積回路(IC)を中心とした半導体製品、その他電子部品、コンピュータ・ネットワーク機器、ソフトウェア等の設計・開発・仕入・販売等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	四半期連結損益 計算書計上額 (注)3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置	PV 製造装置	電子部品・ 情報通信機器				
売上高	194,792	9,393	3,288	47,208	5,702	260,385	△5,885	254,500
セグメント利益 又は損失(△)	21,532	△753	△5,722	226	718	16,000	△16,321	△321

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流、施設管理及び保険業務等を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額△16,321百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△9,806百万円であります。

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純損失と調整を行っております。

③ 報告セグメントの変更等に関する事項

TEL Solar Holding AGを連結子会社としたことに伴い、第1四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の「FPD/PV製造装置」から「FPD製造装置」及び「PV製造装置」に変更しております。

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。